

公司代码：603893

公司简称：瑞芯微

**瑞芯微电子股份有限公司**  
**2022 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利总额为104,394,525.00元，资本公积不转增。公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞芯微	603893	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林玉秋	翁晶
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼
电话	0591-86252506	0591-86252506
电子信箱	ir@rock-chips.com	ir@rock-chips.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （1）行业基本情况及政策

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造和集成电路封装测试三个主要环节。集成电路的生产流程以集成电路设计为开端，由集成电路设计公司根据终端客户需求设计出电路

图，然后委托芯片制造厂根据设计的电路图进行晶圆加工，再委托封装厂进行集成电路的封装和测试，最后将产品销售给计算机、网络通信、汽车电子、消费电子等行业终端客户。近年来，随着 5G 应用、汽车电子、数据中心服务器、人工智能应用、云计算、AR/VR 以及可穿戴设备等应用领域的逐步成熟和发展，集成电路行业进入了加速发展的快车道。

作为信息产业的核心，集成电路行业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其产业能力决定了各应用领域的发展水平，现已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。报告期内，国家有关部门及各地方政府先后出台多项政策支持、鼓励集成电路行业的发展，主要如下：

2022 年 1 月 12 日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。

2022 年 3 月 15 日，国家发展和改革委员会等五部委印发《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，明确了享受税收优惠政策的重点集成电路设计领域和重点软件领域。

2022 年 6 月 23 日，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，指出将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态，充分发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用，促进经济社会高质量发展。

2022 年 11 月 1 日，工信部等五部委联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》，明确指出到 2026 年，我国虚拟现实产业总体规模超过 3500 亿元，虚拟现实终端销量超过 2500 万台的整体目标。

2022 年 11 月 21 日，工信部等三部委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出要加大政策力度优化发展环境，加强产业政策与金融政策协同，发挥产融合作平台作用，综合运用信贷、债券、基金、保险、专项再贷款等各类金融工具，促进集成电路、新能源汽车、生物技术、高端装备、绿色环保等重点产业创新发展。

2022 年 12 月 14 日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》（以下简称“《规划纲要》”），提出要加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。同时，《规划纲要》指出，要壮大战略性新兴产业，全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用；要加快推动数字产业化和产业数字化，加强数字社会、数字政府建设，发展普惠性“上云用数赋智”，不断提升数字化治理水平。

## （2）公司所处的行业地位

公司是中国领先的 SoC 芯片设计公司之一，获得高新技术企业、国家企业技术中心的认定，拥有二十年以上深厚的技术底蕴和丰富的行业市场经验。公司以客户需求为导向，以技术创新为核心，围绕“大音频、大视频、大感知、大软件”的技术发展方向，深耕 AIoT 市场，并积极开拓新的赛道，比如汽车电子。经过二十多年的创新发展，公司在高性能芯片设计、影像视觉处理、

高清视频编解码、神经网络处理及系统软件等开发上具有丰富的经验和技術储备，形成了多层次、多平台、多场景的专业解决方案，赋能汽车电子、机器视觉、教育办公、消费电子、商业金融、工业应用等多元领域。

报告期内，公司先后荣获多个奖项与荣誉，主要如下：

2022年6月15日，胡润研究院发布了《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》，榜单列出元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强，公司位列最具潜力TOP50。

2022年7月23日，中国企业评价协会发布了“2021中国新经济企业500强”榜单，公司入选该榜单。

2022年8月30日-31日，在2022年度（第四届）高工智能汽车市场峰会上，公司被评为“2022年度智能网联中国百强供应商”。

2022年11月17日，2022年第十七届“中国芯”集成电路产业促进大会重磅发布了“中国芯”优秀产品名单及颁发了“中国芯”特别成就企业奖项，公司荣获“特别成就奖”及新一代旗舰芯片RK3588获“优秀技术创新产品”奖。

### （3）公司从事的业务

公司主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，采用行业常用的 Fabless 经营模式，芯片的制造、封装、测试均委托专业的晶圆制造、封装测试企业完成，待取得芯片成品后对外销售并提供技术服务。

公司拥有一支以系统级芯片、模拟电路芯片设计和算法研究为特长的研发团队，在处理器和数模混合设计、多媒体处理、影像算法、人工智能、系统软件开发上具有丰富的经验和技術储备。公司主要产品除各类型处理器芯片外，还包括电源管理芯片、数模混合芯片、光电产品及开发板产品。公司产品主要应用于广义 AIoT 市场，经过二十余年发展，已形成了丰富的产品矩阵和市场布局，在推动芯进百行百业的过程中积累了强大的技术能力和庞大的客户资源，形成了独特的竞争优势。

AIoT 市场持续扩大，主要得益于 AIoT 技术的探索与进步，以及产品的不断丰富和完善，在解决行业痛点、赋能企业转型升级方面持续发力。AIoT 市场发展遵循两大逻辑：

①百行百业的智能化升级带来的需求发展逻辑：通过 AIoT 技术的应用，无论是工业，农业，生产制造、物流运输、医疗、教育还是服务业，都可以实现智能化和人工智能化，从而提高效率和质量。虽然各个行业对于 AIoT 的需求发展阶段不同，产品以点为主，还未形成面，但都将经历从低性能 SoC 到高性能高算力 SoC 的转变。这种转变带来了持续的、多层次的、不断增加的对 SoC 的需求。

②AIoT 的音频、视频、感知等技术发展逻辑：AIoT 多场景应用在形态上千差万别，所使用的技术也种类繁多，但是其核心技术是围绕着音频、视频、感知等技术发展。公司自创立以来，先后拓展“大音频”、“大视频”、“大软件”、“大感知”等相关技术及应用，并且持续积累迭代，与 AIoT 的技术大部分契合。近年来随着 AIoT 的应用与发展，公司坚持这四个技术发展方向，持续提供更优质的产品 and 解决方案。

我们长期深耕 AIoT 领域，不断扩展并完善 SoC 及周边配套芯片，以赋能多领域、多场景的 AIoT 终端应用为己任。基于对行业丰富的经验积累和深刻的理解，公司目前的 AIoT 系统级芯片产品广泛应用于汽车电子、机器视觉、教育办公、消费电子、商业金融、工业应用等众多领域。

#### (4) 公司主要产品

公司的主要产品智能应用处理器芯片,是 SoC 芯片的一种,属系统级的超大规模数字 IC。SoC 芯片行业门槛较高,需要设计公司具备综合研发能力。在数字技术上,需要音频、视频、影像处理等算法实现并完成算法的 IP 化;在体系架构上,需要比较完美地解决存储效率、数据路径、系统功耗等问题,并具有形成系统中最关键的性能优化、电源域管理、功耗处理等技术能力。

公司产品涵盖智能应用处理器芯片、数模混合芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的模组产品等,不同性能、算力、制程的芯片产品高低搭配,满足不同的应用场景,同时丰富周边芯片配套产品,通过不同芯片的排列组合,能够为千行百业的客户提供综合解决方案。公司主要产品分类如下:

##### ①智能应用处理器芯片

公司的智能应用处理器芯片均为 SoC,一般内置中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU),根据使用场景的需要增加影像视觉处理器(ISP)、神经网络处理器(NPU)及多媒体视频编解码器等处理内核。芯片内部有高速总线负责各个处理单元和外部接口的数据传输,同时会配备闪存接口、存储接口、显示接口、网络接口以及各种高速、低速数据传输接口。

公司的 SoC 芯片既可以用于传统消费电子,也可以应用于 AIoT 产业。AIoT 产业包含“云、管、边、端、用、服务”板块,其中公司 SoC 产品主要应用于端侧,作为终端设备的大脑,执行智能算法、输入输出、用户交互等功能,是产品的核心部件。此外,公司的部分中高端芯片也可用于边缘计算,对多路终端进行智能分析和管理的,从而减轻网络和终端的压力。

##### ②数模混合芯片

公司的数模混合芯片产品包括电源管理芯片、快充协议芯片、多媒体接口和无线芯片等芯片。这些芯片负责完成特定的功能,一般在整机中起辅助作用。

电源管理芯片是承担对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片,主要包括电源变换电路、低压差线性稳压器、上电时序管理以及电压控制等电路,根据应用的需要,部分电源管理芯片还集成电池充电管理、电量检测等功能,是集成模拟电源芯片和数字逻辑管理的数模混合电路,在实际推广的过程中与公司的应用处理器配套形成完整的硬件设计方案。报告期内,公司的 RK809M、RK806M 系列电源管理芯片已顺利通过 AEC-Q100 认证。

快充协议芯片主要由电压检测、电流检测、恒流恒压管理、MCU 和通讯端口组成,可以分为适配器协议芯片和手机端协议芯片两种。公司目前已有手机专用适配器芯片、手机专用终端芯片以及多协议快充适配器芯片三种细分产品系列。

公司的其他芯片还包括针对特定功能而设计的特殊应用的 ASIC 芯片,具体为接口转换芯片、无线连接芯片、MCU 芯片等,用于实现显示接口扩展、无线连接、音频播放等功能。这些芯片和公司的智能应用处理器芯片形成配套,增强公司解决方案的竞争力。同时公司也积极开拓该类芯片的外部市场,实现规模效益。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年	2020年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	3,370,213,984.13	3,378,707,945.06	-0.25	2,718,422,251.63
归属于上市公司股东的净资产	2,920,354,658.28	2,850,578,033.95	2.45	2,260,803,296.12
营业收入	2,029,675,088.24	2,718,602,121.55	-25.34	1,863,387,214.10
归属于上市公司股东的净利润	297,427,269.93	601,778,469.15	-50.58	319,972,560.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,521,611.26	445,544,292.94	-61.28	271,829,892.38
经营活动产生的现金流量净额	-622,485,186.13	290,371,555.38	-314.38	560,479,615.19
加权平均净资产收益率(%)	10.35	24.05	减少13.70个百分点	15.32
基本每股收益(元/股)	0.72	1.45	-50.34	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.45	-50.34	0.79

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	542,930,344.84	698,916,457.57	328,440,626.96	459,387,658.87
归属于上市公司股东的净利润	84,146,041.84	188,140,326.28	3,702,366.94	21,438,534.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,974,683.63	119,953,529.54	-23,151,034.10	-255,567.81
经营活动产生的现金流量净额	-101,624,419.35	-30,382,746.85	-316,424,442.45	-174,053,577.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

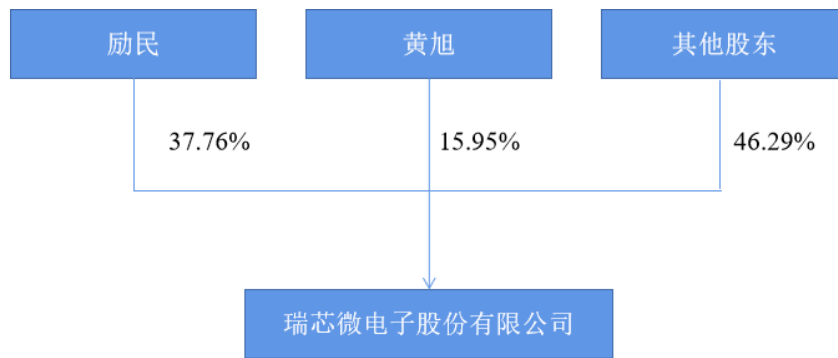
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							29,968
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							27,662
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
励民	0	157,679,892	37.76	157,679,892	无	0	境内自然人
黄旭	0	66,600,108	15.95	66,600,108	无	0	境内自然人
厦门市润科欣投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	30,777,740	7.37	0	无	0	境内非国有 法人
国家集成电路产业投资基金股份 有限公司	0	20,501,149	4.91	0	无	0	国有法人

招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	12,812,809	19,375,124	4.64	0	无	0	其他
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,623,600	16,961,400	4.06	0	无	0	境内非国有法人
厦门腾兴众和投资合伙企业（有限合伙）	-2,363,072	12,752,538	3.05	0	无	0	境内非国有法人
厦门普芯达投资合伙企业（有限合伙）	-1,426,656	10,713,684	2.57	0	无	0	境内非国有法人
厦门芯翰投资合伙企业（有限合伙）	-1,280,200	7,172,337	1.72	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	-999,993	4,000,030	0.96	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	励民、黄旭为一致行动人，公司控股股东、实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

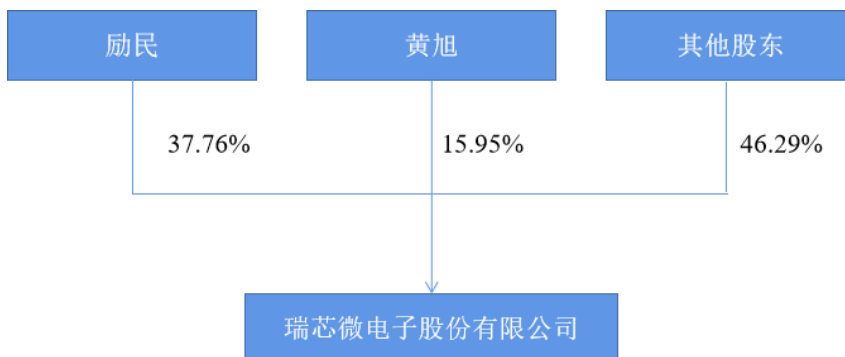
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 2,029,675,088.24 元，同比减少 25.34%，归属上市公司股东净利润 297,427,269.93 元，同比减少 50.58%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用